

논문 98-7-5-11

PLD 장치를 이용한 NbS₂ 박막의 제작

박종만, 이혜연, 정중현

Preparation of NbS₂ thin film using PLD method

Jong-Man Park, Hea-Yeon Lee and Jung-Hyun Jeong

요약

기능성 소자 응용을 위한 다양한 박막을 성장시키기 위하여 PLD(Pulsed Laser Deposition) 장치를 제작·개발하였다. 이 PLD 장치를 이용하여 NbS₂ 박막을 Al₂O₃(012) 기판과 Si(111) 기판 위에 성장시켰다. 결정성 박막의 성장조건을 조사하기 위하여 기판온도를 실온~600 °C, 타겟의 성분비(S/Nb)를 2.0~5.25로 변화시켰다. XRD 패턴으로부터 기판온도가 600 °C이고 타겟의 성분비가 4.0일 때 c-축 배향을 나타내는 양호한 결정성의 NbS₂ 박막이 성장되었다. Si(111) 기판 위보다 Al₂O₃(012) 기판 위에서 보다 양질의 NbS₂ 박막이 성장되었음을 알 수 있었다.

Abstract

We developed a pulsed laser deposition(PLD) apparatus for depositing various thin films. In this study, the formation of NbS₂ thin film was performed in the vacuum chamber by PLD method. Al₂O₃(012) and Si(111) were used as the substrates. In order to investigate the growth conditions of a high crystalline NbS₂ thin film, the S/Nb composition ratio was varied from 2.0 to 5.25 and the substrate temperature was varied from the room temperature to 600 °C. From the result of X-ray diffraction studies of the prepared NbS₂ thin films, it was reported that the NbS₂ thin film showed a good crystallinity at substrate temperature 600 °C and with S/Nb composition ratio 4.0 on Al₂O₃(012) but did not on Si(111). The films exhibited c-axis orientation.

I. 서 론

고에너지를 가진 펄스 레이저광을 진공챔버 안의 고체 표면 위에 렌즈를 이용하여 집광시켜 주면 고체 표면이 폭발적으로 박리분해되어 이온, 원자, 분자 등이 방출된다. 이러한 현상을 레이저 어블레이션(laser ablation)이라 하며, 이 때 방출된 입자를 기판 위에 증착시켜 박막을 만드는 방법이 레이저 증착법(Pulsed Laser Deposition : PLD)이다. 그림 1은 PLD법으로 박

막을 제작하는 과정을 설명한 개략도이다. 펄스 레이저 광이 타겟 표면에 조사되면 표면으로부터 원자, 분자, 이온 등으로 이루어진 플라즈마가 형성되고, 이 입자들이 기판 위에 증착되어 박막으로 성장하게 된다. 이 때 필요에 따라 진공장치 안으로 적당량의 가스를 흘려보내 반응가스 분위기에서 박막을 성장시킬 수 있다.

이 방법을 이용한 박막 제작에 관한 연구는 1965년 Smith와 Turner에 의해 처음으로 보고되었다^[1]. 그 후 레이저 기술의 발전^[2]에 힘입어 PLD 기법을 이용한 박막 성장에 관한 연구가 활발히 진행되어 왔다. 최근에는 다양한 물질의 박막을 제작하고 물성을 조사하여

반도체 소자와 같이 집적회로를 구성할 수 있는 기능성 소자를 개발하기 위한 많은 연구가 보고되어 있다^[3-9]. PLD 기법의 장점은 1) 타겟과 화학양론적으로 일치하는 박막을 제작할 수 있고, 2) 반응가스 분위기에서 사용 가능하며, 3) 작은 타겟을 사용할 수 있다는 점이다^[10].

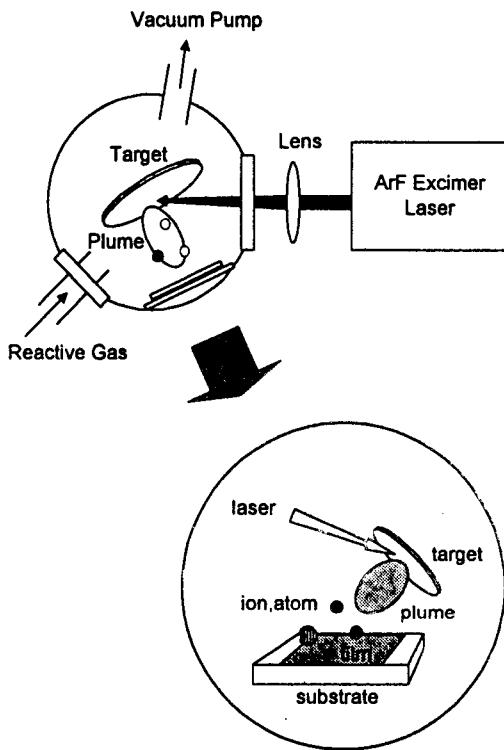


그림 1. PLD법에 의한 박막형성의 개략도.

Fig. 1. A scheme of thin film formation by PLD (Pulsed Laser Deposition) method.

본 연구에서는 다양한 박막을 성장시키기 위한 PLD 장치의 제작·개발에 관한 내용을 기술하고, 이러한 PLD 장치를 이용하여 실온에서는 금속의 성질을 가지고 6K에서는 초전도성을 띠는 NbS₂ 박막 제작을 보고하고자 한다. 이러한 물질은 산화물과 달리 박막 성장시 가스가 필요하지 않기 때문에 깨끗한 표면과 양질의 박막의 성장이 기대된다. 제작한 NbS₂ 박막의 결정 구조는 XRD 패턴과 EDX 분석 결과로 논의하였다. 또한 기판과의 의존성에 대하여서는 Al₂O₃(012) 기판과 Si(111) 기판 위에 성장시켜 토의하였다.

II. 장치구성 및 실험

그림 2는 레이저와 진공장치로 구성한 실험장치의 개략도이다. 레이저는 193 nm ArF excimer laser를 사용하였다. 진공장치는 TMP(Turbo Molecular Pump)를 사용하여 진공으로 만들어지며 진공장치의 진공도는 1×10^{-7} Torr가 유지되도록 하였다. 진공장치 내부는 중앙을 중심으로 타겟홀더와 히터가 내장된 기판홀더가 수평으로 설치되어 있고 기판홀더를 전후로 이동시켜서 타겟-기판 사이의 거리를 조정할 수 있도록 설계·제작하였다. 타겟홀더는 4 개가 각각 자전 및 공전을 하도록 제작하였다. 또한 일정한 진공조건에서 연속적인 실험을 위하여 기판을 *in situ*로 교체가 가능하도록 보조 진공장치를 연결하였다. 박막의 성장 방법은 레이저광을 렌즈로 집광시켜 타겟 표면 위에 약 45°로 조사시켜 타겟 표면으로부터 수직으로 플라즈마가 형성됨으로써 맞은 편에 있는 기판 위에 증착되어 박막을 형성하게 된다.

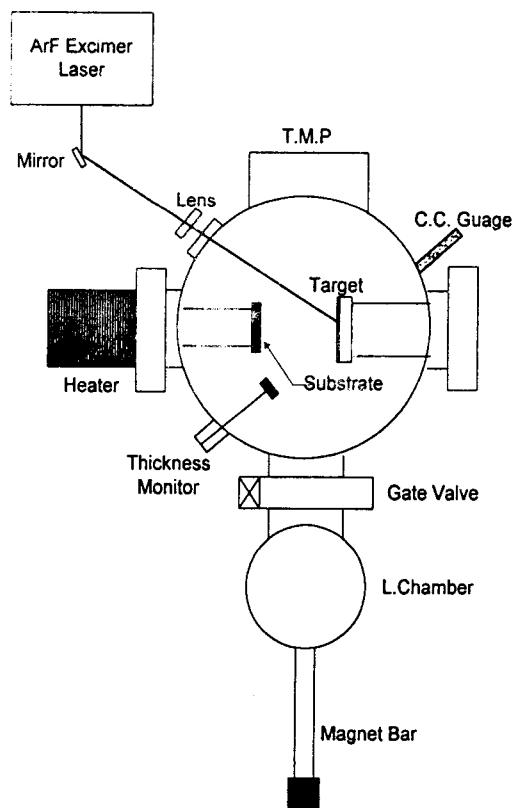


그림 2. PLD 실험장치의 개략도.

Fig. 2. A schematic of PLD system.

NbS₂ 박막은 진공도 1×10^{-7} Torr, 레이저 에너지 200 mJ/pulse, 속도 3~5 Hz로 성장시켰다. 타겟에서 기판까지의 거리는 5 cm 였다. Al₂O₃(012) 기판은 깨끗한 표면을 얻기 위해서 진공장치 안에서 700°C로 한 시간 동안 가열하였으며, Si(111) 기판은 표면의 SiO₂ 층을 제거하기 위해서 불산으로 에칭처리하여 사용하였다. 박막 성장의 최적조건을 조사하기 위하여 기판온도를 실온~600°C로 변화시키고, 타겟의 성분비를 2.0~5.25로 변화시켰다. 타겟은 NbS₂ 분말에 황 분말을 화학양론적으로 첨가하여 성분비를 조정하였고 직경 10mm pellet(150 kg/cm² 전공 압력기)으로 제작하였다. 박막 성장속도는 약 1~2 Å/s였고 박막 두께는 2000~3000 Å이었다. 박막의 두께는 in-situ thickness monitor와 ex-situ 중에서는 광학현미경으로 측정하였다. 박막의 결정구조는 CuK α 의 XRD 패턴으로 관찰하였고 박막의 정성·정량분석은 EDX으로 측정하였다.

III. 결과

일반적으로 황은 높은 기판온도에서 쉽게 재증발하므로 화학성분비의 조절은 NbS₂ 박막 제작에 있어서 가장 중요한 요소 중의 하나이다. 우선 박막구조와 타겟 성분과의 관계를 조사하였다.

그림 3은 타겟의 S/Nb 성분비를 증가시킴에 따라서 기판 Al₂O₃(012) 위에 형성된 NbS₂ 박막의 XRD 패턴을 보여준다. 기판온도는 600 °C로 고정시켰다. 그림 3(a)는 타겟의 성분비가 3.5일 때 박막의 결정성이 좋지 않음을 보여준다. S/Nb 성분비가 4.0으로 증가함에 따라서 미지의 불순물이 조금 섞였지만 좋은 결정성을 갖는 NbS₂ 박막을 얻었다. NbS₂ 박막은 그림 3(b)의 두렷한 (00 *l*) 피크들이 나타내듯이 c-축 배향성을 나타낼 수 있다. 타겟의 성분비가 5.25로 증가하였을 때, 박막에 대한 회절강도는 그림 3(c)와 같이 불규칙한 배향의 분말에 대한 강도와 거의 일치한다. EDX에 의해 측정된 그림 3(a), 3(b), 3(c)에 보인 박막의 S/Nb 성분비는 각각 1.3, 2.1, 2.8이었다. XRD 패턴과 EDX 측정에 의해 박막의 성분비가 Nb:S=1:2인 화학양론적 값에 근사할 때 NbS₂ 박막은 c-축 배향을 나타낼 수 있다.

기판온도의 영향은 타겟 성분비를 4.0으로 고정시켜서 관찰하였다. 그림 4는 기판온도 400~600 °C에서 제

작된 NbS₂ 박막의 XRD 패턴을 보여준다.

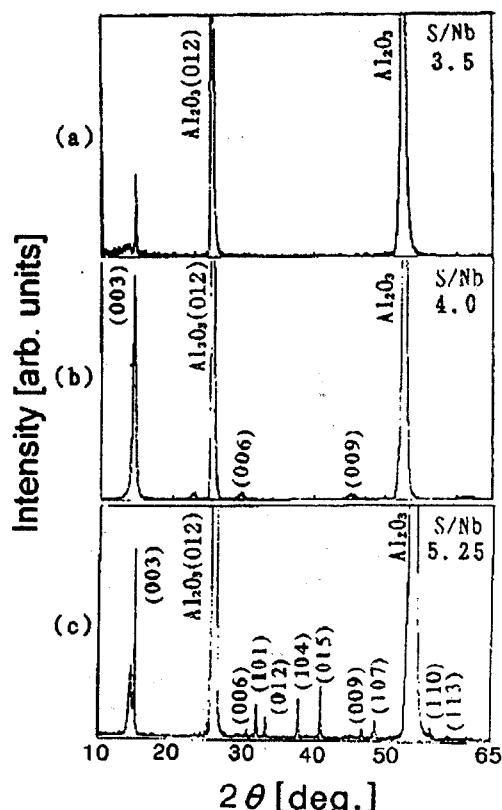


그림 3. 기판온도가 600 °C이고 타겟 성분비가 (a) 3.5, (b) 4.0 및 (c) 5.25인 타겟으로 Al₂O₃(012) 위에 성장시킨 NbS₂ 박막의 XRD 패턴.

Fig. 3. The XRD pattern of NbS₂ thin films on Al₂O₃(012) at 600 °C and with target composition ratio (S/Nb) (S, sulfur) of (a) 3.5, (b) 4.0 and (c) 5.25.

기판온도가 500 °C 이하에서 성장된 박막은 그림 4(a), 4(b)에서와 같이 (00 *l*) 회절 피크를 보이지 않는다. 즉, 양호한 결정성을 갖는 NbS₂ 박막은 만들어지지 않은 것을 알 수 있다. 기판온도가 500 °C 이하에서는 NbS₂ 박막은 타겟 성분과 관계없이 미약한 결정성을 보인다. 기판온도가 600 °C로 증가할 때는 그림 4(c)에서 보여주는 것과 같이 결정성이 양호한 NbS₂ 박막으로 성장되었다. 그림 4(c)에서 $2\theta = 13^\circ$ 와 $2\theta = 22.5^\circ$ 의

회절 피크는 미지의 불순물 피크들이다. 이러한 결과를 통하여 NbS₂ 박막은 기판온도 600 °C에서 결정성을 갖는다는 것을 보여준다. 결론적으로 Al₂O₃(012) 기판 위에서 NbS₂ 박막의 결정성은 기판온도에 의존함을 알 수 있다.

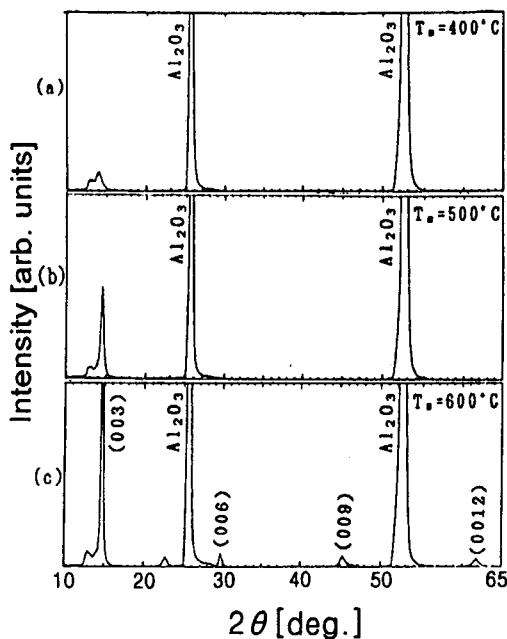


그림 4. 타겟 성분비가 4.0이고 기판온도가

(a) 400 °C, (b) 500 °C 및 (c) 600 °C인 경우 Al₂O₃(012) 위에 성장시킨 NbS₂ 박막의 XRD 패턴.

Fig. 4. The XRD pattern of NbS₂ thin films on Al₂O₃(012) at S/Nb=4.0 and substrate temperatures of (a) 400 °C, (b) 500 °C and (c) 600 °C.

그림 5는 위의 결과에 의해 NbS₂ 박막의 성장조건을 나타내는 다이아그램이다. ○ 부분은 기판온도가 600 °C 이상인 부분으로 타겟 성분비는 4.0 또는 4.5이다. 이 조건하에서는 c-축 배향성을 가진 양호한 결정성의 NbS₂ 박막이 성장되었다(그림 3(b), 4(c)). □ 부분은 기판온도를 감소시킴에 따라 표면의 결정에너지 결핍으로 박막의 결정성이 약해지고(그림 4(a), (b)), 온도가 증가해도 박막 성분이 S/Nb<2.0일 때는 박막의 결정성이 약하다는 것을 알 수 있다(그림 3(a)). 즉 그림 5에서 점선 아래 부분은 결정성이 약한 박막

이 형성되는 영역이다. 또한 △ 부분은 타겟의 성분비가 5.0 이상이고 박막 성분이 S/Nb>2.0인 부분으로, 이 때 NbS₂ 박막은 결정성은 가지지만 배향성은 형성되어 있지 않음을 알 수 있다(그림 3(c)). 따라서 Al₂O₃(012) 기판에서 높은 결정성의 NbS₂ 박막을 얻기 위해서는 기판 온도와 타겟의 성분(S/Nb)비를 잘 조절하여야 함을 알 수 있다. 다이아그램에서 구분선들은 개략적인 것이다.

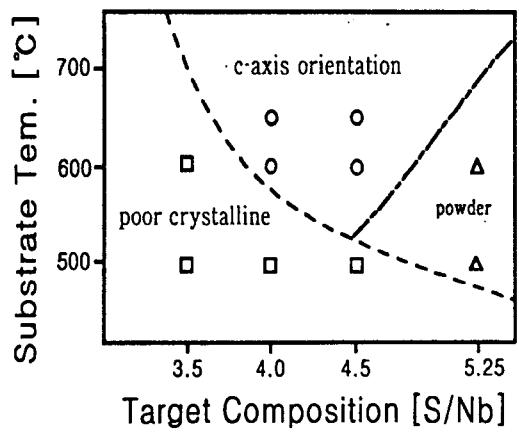


그림 5. 기판온도와 타겟 성분비에 따른 NbS₂ 박막 성장의 개략도.

Fig. 5. A diagram of the substrate temperature and target composition for NbS₂ films.

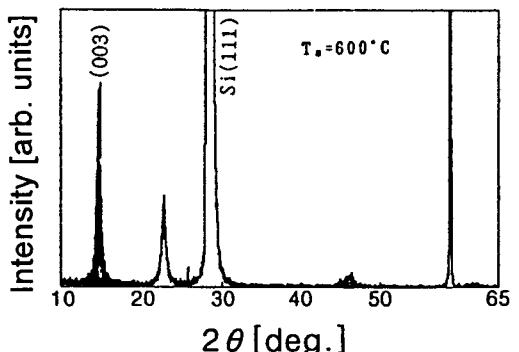


그림 6. 타겟 성분비가 4.0이고 기판온도가 600 °C인 경우 Si(111) 위에 성장시킨 NbS₂ 박막의 XRD 패턴.

Fig. 6. The XRD pattern of NbS₂ thin film on Si(111) at 600 °C and with S/Nb=4.0.

그림 6은 Si(111) 기판 위에서 성장시킨 NbS₂ 박막

의 XRD 패턴이다. 기판온도는 600 °C이고 S/Nb 성분비는 4.0이다. 이때 Si(111) 위의 NbS₂ 박막은 Al₂O₃(012) 위의 박막보다 결정성이 나쁘다는 것을 알 수 있다. 이는 박막이 증착하기 전에 Si(111) 기판면의 산화와 경계면 확산으로 인하여 거칠어진 표면 때문으로 생각된다.

IV. 결 론

본 연구에서는 PLD 장치를 제작·개발하여 NbS₂ 박막을 성장시켰다. 결정성의 NbS₂ 박막을 성장시키기 위하여 기판온도와 타겟 성분비를 변화시키면서 Al₂O₃(012) 기판과 Si(111) 기판 위에 NbS₂ 박막을 제작하였다. NbS₂ 박막의 결정성은 기판온도와 타겟 성분비에 의존한다는 사실을 알 수 있었다. 기판온도가 600 °C이고 타겟 성분비가 4.0일 때 Al₂O₃(012) 기판 위에서는 c-축 배향성을 가진 양호한 결정성의 NbS₂ 박막이 성장하였으나 Si(111) 기판 위에서는 결정성의 박막이 성장하지 않았다.

감사의 글

* 본 연구는 부경대학교 연구비 지원에 의해 수행되었으며 이에 감사드립니다.

참 고 문 헌

- [1] H.M.Smith, and A.F.Turner, Appl.Optics. 4, 147 (1965).
- [2] Hass, G., and J.B.Ramsey, Appl.Opt. 8(6), 1115 (1969).
- [3] D.Dijikaamp, T.Venkatesan et al, Appl.Phys.Lett. 51, 619 (1987).
- [4] H.Lee, M. Kanai et al, Jpn.J.Appl.Phys. 32, 2100 (1993).
- [5] H.Lee, M. Kanai, and T.Kawai, Thin Solid Films 277, 98 (1996).
- [6] D.H.Lowndes, D.B.Geohegan et al, Science 273, 898 (1996).
- [7] 김인선, 박용기, 새물리 38, 184 (1998).
- [8] S.B.Desu, H.S.Cho, and M.Nagata, Phys.Stat.Sol. 165, 213 (1998).
- [9] S.H.Lee, T.K.Song, T.W.Noh, and J.H.Lee, Appl.Phys.Lett. 67(1), 43 (1995).
- [10] K.L.Saenger, Processing of Advanced Materials 2, 1 (1993).

著 者 紹 介

정중현

『센서학회지 제3권 제2호』 논문 94-3-2-02, p.15 참조
현재 부경대학교 자연과학대학 물리학과 교수

이혜연

『센서학회지 제6권 제5호』 논문 97-6-5-09, p.413 참조
현재 부경대학교 자연과학대학 화학과 국내 Post-doc

박종만

『센서학회지 제7권 제1호』 논문 98-7-1-10, p.72 참조
현재 부경대학교 자연과학대학 물리학과 시간강사